

2008-2009年中国IC卡行业研究咨询报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2008-2009年中国IC卡行业研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxinshebei/3161731617.html>

报告价格：电子版: 6300元 纸介版：6800元 电子和纸介版: 7300

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

近几年，中国IC卡行业步入产业分工合作、规模应用起步、产品由低端向高端延伸发展的新阶段，产品结构调整、应用技术升级和优化资源配置稳步推进，表现出应用技术多元化、产品价格持续下滑、应用需求差异化、卡片市场国际化的典型特征。整个行业面临资本、技术、市场、配套、经营等多方面新的压力和挑战，同时还面临海外市场拓展的若干困难。在这种情况下，加速产业结构调整，完善产业链的建设，探索差异化的竞争战略，逐渐向高附加值环节转移，通过加强合作来协调优化市场环境，积极探索海外市场的发展，成为中国IC卡行业实现可持续发展的重要手段。

2008年起我国将支持产、学、研、用相结合的金卡工程多功能卡应用联盟的发展，加强跨部门、跨行业、跨地区的合作，拟定相关政策措施，引导和支持产用结合和融合发展。同时，建立第三方产品及安全检测认证中心，确保IC卡安全使用。开展法规保障、安全管理和技术防范体系等IC卡应用安全体系建设，探索运用公开密钥密码等技术，构建密码技术信息安全保障基础设施。目前，我国行业性IC卡应用覆盖电信、社会保障、公安、税务、交通、建设及公用事业、卫生、石油石化、组织机构代码管理等多个领域，发卡总量超过50亿张。随着IC卡应用范围不断扩大，各类IC卡的功能扩展和相互融合加快。

中国智能卡市场的庞大让国外产业巨头看到了巨大市场前景，于是出现了以英飞凌为代表的国际大厂抢攻这个市场的局面。目前，在重要的智能卡市场上，芯片供应商集中为英飞凌、瑞萨、飞利浦、ST等国际半导体巨头，国内智能卡芯片设计企业的份额很少，而且技术水平和产品的稳定性也处于落后状态。通过FCOS的快速上马可以看出，英飞凌将未来智能卡的门槛提高了。一旦3G应用铺开，在USIM卡领域，也许将出现只有大唐微电子一家对抗外国供应商的局面，本土智能卡芯片供应商应当加强研发，积极布局。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国信息产业商会智能卡专业委员、中国智能卡信息、国际电子商情、卡市场信息网等提供的大量基础资料，以及对我国IC卡市场现状、发展趋势及其所面临的问题等进行的深入调研。报告全面总结了2008年中国城市IC卡的应用发展状况和特点，深入解析了IC产业链，介绍了IC卡优企业并对其竞争策略进行了综合评价，分析了IC卡应用需求以及市场供给的情况，对市场竞争整体格局做出建议。在此基础上，深入研究了未来IC卡市场趋势和市场规模。报告还综合研究了当前我国IC卡行业面临的国际市场竞争与挑战。本报告内容简练、论述精辟，在撰写过程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是IC卡行业、相关企业单位准确了解目前中国IC卡市场发展动态，把握IC卡发展趋势，制定市场策略的首选精品。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状分析

第一章 IC卡及其相关知识 1

第一节 IC卡概况 1

一、IC卡历史 1

二、IC卡定义 2

三、IC卡分类 3

第二节 IC卡应用模式 9

一、健康保险卡的应用 10

二、电信方面的应用 10

三、金融方面的应用 13

四、智能建筑物应用 17

五、交通方面的应用 20

六、公共事业方面的应用 20

第二章 无线射频识别技术RFID 31

第一节 RFID概况 31

一、RFID技术简介 31

二、RFID系统工作原理及其结构 32

三、RFID系统分类 34

四、RFID技术发展历程及应用现状 35

第二节 RFID行业发展分析 40

一、2008年我国RFID市场综合回顾 40

二、2008年全球RFID行业综合回顾 45

三、我国RFID应用发展状况分析 50

四、2015年上海市RFID销售额预测 56

五、2008年广东RFID技术发展应用状况 57

六、RFID行业发展振兴策略 59

第三节 RFID在行业中应用分析 63

一、RFID技术和ERP结合应用分析 63

二、RFID在传统制造业MES应用分析 64

三、RFID技术在医疗行业中应用分析 73

四、RFID在开架书库管理中应用分析 77

五、RFID技术在铁路施封锁中应用分析 79

第四节 RFID行业发展趋势 83

一、2011年RFID占供应链市场份额预测 83

二、中国RFID软件与系统集成市场规模预测 84

三、RFID行业发展趋势 85

- 四、2009年中国RFID市场展望 87
- 五、全球RFID发展趋势 87
- 第三章 EMV磁卡转智能卡发展现况 90
 - 第一节 EMV迁移发展分析 90
 - 一、EMV迁移简介 90
 - 二、EMV迁移发展历程 90
 - 三、国际EMV迁移现状分析 91
 - 四、我国EMV迁移现状分析 95
 - 第二节 2008年EMV发展动态分析 102
 - 一、2008年国外EMV动态分析 102
 - 二、EMV非接触IC卡终端输入点规范分析 104
 - 三、2008年工行发行EMV标准白金卡情况 105
 - 四、2008年金邦达EMV产品供应形势分析 105
- 第四章 IC卡市场现状分析 107
 - 第一节 国际IC卡发展状况 107
 - 一、IC卡国际标准分析 107
 - 二、国际IC卡发展状况分析 108
 - 三、全球智能卡应用现状 120
 - 四、2011年全球移动支付市场规模预测 126
 - 第二节 中国IC卡市场发展状况分析 127
 - 一、中国IC卡市场发展状况 127
 - 二、2008年我国IC卡发展走向分析 135
 - 三、2008年我国公交统一IC卡应用情况 136
 - 四、2008年佛山市IC卡应用情况分析 137
- 第二部分 行业产业链分析
- 第五章 IC卡芯片供需分析 139
 - 第一节 中国集成电路产业发展分析 139
 - 一、中国集成电路产业发展现状 139
 - 二、集成电路装备制造业发展状况 141
 - 三、2008年前三季度中国集成电路产业运行状况 143
 - 四、2008年中国集成电路市场发展状况分析 143
 - 第二节 我国集成电路产业发展分析 147
 - 一、中国集成电路产业转变分析 147
 - 二、我国混合集成电路国产化率分析 152
 - 三、2008-2009年集成电路产业整合创新策略 155

第三节 2008年我国地方集成电路产业发展状况	158
一、2008年重庆集成电路产业发展状况	158
二、2008年前三季度上海集成电路产业发展状况	162
三、2008年苏州集成电路产业发展现状	162
第六章 IC卡封装测试业发展分析	164
第一节 IC卡封装测试业发展状况	164
一、IC封测业发展概况	164
二、IC卡封装测试业发展状况	166
三、IC卡封装测试产业格局分析	168
第二节 IC卡封装测试业发展挑战与机遇	169
一、中高端封装市场商机分析	169
二、封装测试业发展机遇分析	172
三、封装测试业发展问题及对策分析	174
四、封装测试业负面因素影响分析	175
第三节 台湾IC卡封装测试业发展分析	178
一、2008年台湾封测产业发展状况分析	178
二、2008年台湾封装测试厂营运状况	181
三、2008-2009年台湾封测业发展趋势	182
第七章 IC设计产业发展分析	186
第一节 IC设计产业发展状况	186
一、全球IC设计业发展状况分析	186
二、我国IC设计业发展状况	188
三、IC设计师现状分析	193
四、2008年我国芯片设计业形势分析	206
五、深圳IC设计基地集聚效应分析	209
第二节 金融风暴对IC设计产业影响	216
一、2008年金融风暴对IC设计产业影响分析	216
二、2008年我国IC设计业上下游合作应对策略	217
三、2009年我国IC设计业发展措施	220
第三节 2008年我国IC设计产业竞争分析	224
一、2008年我国IC设计产业竞争状况	224
二、2008年我国IC设计业同质化竞争分析	225
三、2008年中国IC设计行业调整分析	229
四、我国IC设计企业合作共赢策略	233
五、2008中国十佳IC设计公司发展分析	234

第八章 IC卡上游企业分析 238

第一节 2008年国际IC卡上游企业概况 238

一、英飞凌科技公司 238

二、ATMEL公司 249

三、三星电子有限公司 256

四、意法半导体有限公司 259

五、飞思卡尔半导体有限公司 261

六、日本瑞萨科技公司 266

第二节 2008年国内主要IC卡公司概况 268

一、珠海炬力集成电路设计有限公司 268

二、中星微电子公司 273

三、北京中电华大电子设计有限责任公司 274

四、杭州士兰微电子股份有限公司 276

五、北京同方微电子有限公司 280

六、上海复旦微电子股份公司 281

七、上海贝岭股份有限公司 283

第三部分 行业产业重点企业分析

第九章 IC卡产业优势企业分析 289

第一节 金雅拓公司 (Gemalto) 289

一、公司简介 289

二、2008年公司亚洲拓展战略分析 289

三、2008年公司部署EDI战略分析 290

第二节 欧贝特卡系统公司 291

一、公司简介 291

二、2008年企业动态 292

第三节 捷德公司 294

一、公司简介 294

二、2008年公司在华发展情况 295

三、2008年公司动态 296

第四节 握奇数据系统有限公司 299

一、公司简介 299

二、2008年公司发展策略 299

三、2008年公司动态 301

第五节 大唐微电子技术有限公司 303

一、公司简介 303

- 二、公司发展历程 304
- 三、2008年公司多元化转型分析 307
- 第六节 上海华虹计通智能卡系统有限公司 308
 - 一、公司简介 308
 - 二、产品系统 309
 - 三、2009年公司整合宏力分析 310
- 第七节 恒宝股份有限公司 311
 - 一、公司简介 311
 - 二、生产资质 311
 - 三、2007-2008年公司财务状况 312
- 第八节 航天信息股份有限公司 317
 - 一、公司简介 317
 - 二、公司竞争力分析 318
 - 三、2007-2008年公司财务状况 320
- 第四部分 行业相关经济因素分析
- 第十章 IC卡发展相关经济要素分析 325
 - 第一节 半导体产业发展分析 325
 - 一、2008年我国半导体行业发展状况 325
 - 二、2008年1-10月我国半导体产量统计 330
 - 三、2008年1-10月半导体进出口统计 334
 - 四、2009年半导体行业发展前景分析 339
 - 第二节 零售产业发展分析 342
 - 一、2008年10-11月中国商品零售市场发展状况 342
 - 二、2008年12月中旬我国消费品零售总额突破情况 343
 - 三、中国网上零售市场淡旺季趋势分析 344
 - 四、中国零售业前景分析 345
 - 第三节 信息产业发展分析 346
 - 一、电子信息产业发展状况 346
 - 二、信息产业应对金融风暴策略 349
 - 三、2008-2012年中国空间信息产业市场规模预测 350
 - 四、2009年我国电子信息产业发展状况 351
 - 第四节 金融业发展分析 352
 - 一、2008年我国金融业改革开放 352
 - 二、中国金融业发展历程分析 356
 - 三、2008年中国金融市场变化分析 358

第十一章 NFC移动支付产业发展分析 363

第一节 SIMpass单芯片NFC移动支付解决方案 363

一、业务背景 363

二、利益分析 363

三、产品介绍 364

四、产品形态 365

五、可支持应用项目 365

第二节 NFC移动支付市场现状及趋势 365

一、NFC移动支付市场发展状况 365

二、NFC产业链第三方变革分析 366

三、2008年NFC移动支付市场竞争状况 367

四、2013年全球NFC交易金额预测 370

第三节 NFC手机发展现状 371

一、2008年支持NFC通信的SD卡研发状况 371

二、2009年四大手机巨头力对NFC手机支持分析 372

三、2009年我国NFC手机标准制定分析 372

第五部分 行业发展趋势分析

第十二章 我国IC卡市场发展趋势 375

第一节 IC卡应用新趋势 375

一、IC卡应用领域完善趋势 375

二、应用细分化趋势 376

三、移动支付与IC卡结合趋势 376

四、IC卡其他应用领域发展趋势 377

第二节 中国IC卡市场趋势展望 378

一、中国IC卡市场厂商发展走向分析 378

二、中国IC卡市场发展前景 379

三、中国IC卡市场发展趋向 379

图表目录

图表：几种卡性能比较 4

图表：IC卡应用领域及类别 5

图表：智能卡在建筑方面的运用 17

图表：公司卡可以应用的范围 17

图表：智能卡在公司资源利用上的应用 18

图表：智能卡在食堂经营上的应用 19

图表：IC卡表管理模式 21

- 图表：IC卡表工作原理图 25
- 图表：北京供电局售电管理系统介绍 27
- 图表：用户卡片文件结构 29
- 图表：ESAM模块文件结构 29
- 图表：管理系统发卡流程示意 30
- 图表：RFID技术发展历程 32
- 图表：2008年世界RFID行业合并和收购情况 47
- 图表：2008年RFID行业的风投资金流动情况 48
- 图表：RFID标准工作组成员组成 55
- 图表：2004-2007年中国RFID市场规模与增长 62
- 图表：2005全球支付卡市场 119
- 图表：2007年世界智能卡市场分布结构 126
- 图表：2007年中国IC卡市场厂商品牌结构 132
- 图表：2003-2007年中国大陆国产IC销售额与出口额增长 135
- 图表：2003-2007年中国大陆国产IC产量 135
- 图表：建设事业IC卡互联互通统一标识 137
- 图表：2006—2008年3季度中国集成电路产业销售额规模及增长 143
- 图表：2004 - 2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率 144
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率 145
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场应用结构 145
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场产品结构 146
- 图表：2008年第3季度上海集成电路各行业累计销售额及同比增长率 162
- 图表：2008年1-9月上海集成电路各行业累计销售额及同比增长率 162
- 图表：2005-2007年专业封装代工厂商占有所有封装市场比例 164
- 图表：2006年年度全球前6大封测企业毛利率统计 165
- 图表：2006年一季度全球前6大封测企业毛利率统计 165
- 图表：2006年全球10大封装公司排名 166
- 图表：全球各封装性质比较 175
- 图表：国内主要独资企业封装形式 176
- 图表：国内主要合资企业封装形式 177
- 图表：国内主要封装企业封装形式 178
- 图表：2007-2009年全球半导体封测市场规模及趋势 182
- 图表：2007年台湾封装产业产品比重 184
- 图表：2005-2009年台湾IC封装产业产值趋势 184
- 图表：2007台湾测试产业产品比重 185

- 图表：2005-2009年台湾IC测试产业产值趋势 185
- 图表：数字ASIC为中国IC设计公司的主体研发产品 191
- 图表：中国IC设计公司开发出的设计类型 191
- 图表：2006年中国IC设计公司设计水平一览表 192
- 图表：消费电子是中国IC产品的主流应用领域 192
- 图表：本土部分多媒体IC一览表 193
- 图表：中国IC公司2006年启动的设计项目 193
- 图表：2007年中国设计工程师人数在企业员工总人数的比例 194
- 图表：2007年中国设计工程师从事与设计 and 开发相关工作的人的比例 194
- 图表：2007年中国电子设计工程师设计的电子产品种类比例 195
- 图表：2007年中国电子设计工程师所在不同业务性质的电子制造公司的比例 195
- 图表：2007年中国电子设计工程师全国分布情况 196
- 图表：2007年中国电子设计工程师平均拥有的工作经验 196
- 图表：2007年中国工程师个人参与设计项目数量的比例 196
- 图表：2007年中国电子设计工程师参与设计全新项目的比重 197
- 图表：2007年中国电子设计工程师在现有设计基础上的改进型项目所占比重 197
- 图表：2007年中国电子设计工程师基于外来系统设计方案所设计项目的比重情况 198
- 图表：2007年中国电子设计工程师面临的挑战情况 198
- 图表：2007年中国电子设计工程师主要致力于设计项目的那些方面 199
- 图表：2007年中国电子设计工程师在原有基础上改进的人数比重 199
- 图表：2007年中国电子设计工程师平均完成一个项目所花费的时间 199
- 图表：2007年中国电子设计工程师在未来2年关注以下中国的标准 200
- 图表：2007年中国电子设计工程师拥有的设计能力比重 200
- 图表：2007年中国电子设计工程师未来两年计划将以下技术应用于设计项目 201
- 图表：2007年中国电子设计工程师面临的普通设计的挑战比例 201
- 图表：2007年中国电子设计工程师设计项目所用资源的出处比重 202
- 图表：2007年中国电子设计工程师针对用于设计解决方案的工具的态度比例 202
- 图表：2007年中国电子设计工程师参与所就职公司的元器件选择过程的情况 203
- 图表：2007年中国电子设计工程师了解最新技术动态的渠道情况 203
- 图表：2007年中国电子设计工程师选择元器件时依靠的渠道 204
- 图表：2007年中国电子设计工程师使用的IC中国外品牌占有情况 204
- 图表：2007年中国电子设计工程师使用的分立元器件中国外品牌情况 205
- 图表：2007年中国电子设计工程师所使用的ASIC生产源地情况 205
- 图表：2008年第一季度英飞凌科技股份有限公司营业收入 240
- 图表：2008年第一季度英飞凌科技股份有限公司息税前利润 240

- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司每股损益情况 241
- 图表：2007-2008年英飞凌汽车、工业和多元化电子市场部（AIM）部门财务状况 242
- 图表：2007-2008年英飞凌通信解决方案部（COM）财务状况 242
- 图表：2007-2008年英飞凌其他业务部门/企业内部调整营业收入 243
- 图表：2007-2008年英飞凌其他业务部门/企业内部调整息税前利润 243
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司合并财务报表 243
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司合并财务报表EBIKT 244
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司合并财务报表净收益和净费用 244
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司各业务领域净销售额 244
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司各业务领域息税前利润 245
- 图表：2007年英飞凌科技股份公司各地区占销售额的比例 245
- 图表：2007年英飞凌科技股份公司合并资产负债表简表 246
- 图表：2007年英飞凌科技股份公司合并资产负债表简表 247
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司合并现金流量表简表 247
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司毛现金头寸和净现金头寸 248
- 图表：2007-2008年英飞凌科技股份公司自由现金流量 248
- 图表：英飞凌科技股份公司2007年员工数量 248
- 图表：2008年三星投资计划 257
- 图表：瑞萨公司概况 266
- 图表：华大电子组织结构 275
- 图表：2007年杭州士兰微电子股份有限公司主要经营指标 279
- 图表：2007年杭州士兰微电子股份有限公司最新异动 279
- 图表：上海贝岭股份有限公司历年简要财务指标 286
- 图表：2004-2007年上海贝岭股份有限公司利润构成和赢利能力 286
- 图表：2004-2007年上海贝岭股份有限公司经营和发展能力 287
- 图表：2004-2007年上海贝岭股份有限公司资产和负债 287
- 图表：2004-2007年上海贝岭股份有限公司现金流量 288
- 图表：2004-2007年上海贝岭股份有限公司异动财务指标 288
- 图表：大唐微电子发展三阶段图示 307
- 图表：2007年4季度恒宝股份有限公司人员构成 312
- 图表：2008年2季度恒宝股份有限公司主营构成 313
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司每股指标分析 313
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司获利能力分析 314
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司经营能力分析 314
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司偿债能力分析 314

- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司资本结构 315
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司发展能力分析 315
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司现金流量分析 315
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司主营业务收入 315
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司主营业务利润 316
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司营业利润 316
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司利润总额 316
- 图表：2007-2008年恒宝股份有限公司净利润 317
- 图表：2007年4季度航天信息股份有限公司人员构成 320
- 图表：2008年2季度航天信息股份有限公司主营构成 320
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司每股指标分析 321
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司获利能力分析 321
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司经营能力分析 321
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司偿债能力分析 322
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司资本结构 322
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司发展能力分析 322
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司现金流量分析 322
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司主营业务收入 323
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司主营业务利润 323
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司营业利润 323
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司利润总额 324
- 图表：2007-2008年航天信息股份有限公司净利润 324
- 图表：半导体销售额的各厂商市场份额 328
- 图表：2008年1-2月我国半导体分立器件产量统计 330
- 图表：2008年1-3月我国半导体分立器件产量统计 330
- 图表：2008年1-4月我国半导体分立器件产量统计 330
- 图表：2008年1-5月我国半导体分立器件产量统计 330
- 图表：2008年1-6月我国半导体分立器件产量统计 331
- 图表：2008年1-7月我国半导体分立器件产量统计 331
- 图表：2008年1-8月我国半导体分立器件产量统计 331
- 图表：2008年1-9月我国半导体分立器件产量统计 331
- 图表：2008年1-10月我国半导体分立器件产量统计 331
- 图表：2008年1-2月我国半导体集成电路产量统计 331
- 图表：2008年1-3月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-4月我国半导体集成电路产量统计 332

- 图表：2008年1-5月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-6月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-7月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-8月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-9月我国半导体集成电路产量统计 332
- 图表：2008年1-10月我国半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-2月我国大规模半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-3月我国大规模半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-4月我国大规模半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-5月我国大规模半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-6月我国大规模半导体集成电路产量统计 333
- 图表：2008年1-7月我国大规模半导体集成电路产量统计 334
- 图表：2008年1-8月我国大规模半导体集成电路产量统计 334
- 图表：2008年1-9月我国大规模半导体集成电路产量统计 334
- 图表：2008年1-10月我国大规模半导体集成电路产量统计 334
- 图表：2008年1月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 334
- 图表：2008年2月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 334
- 图表：2008年3月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年4月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年5月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年6月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年7月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年8月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年9月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年10月我国半导体器件等、已装配的压电晶体进口统计 335
- 图表：2008年1月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年2月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年3月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年4月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年5月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年6月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年7月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年8月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 336
- 图表：2008年9月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 337
- 图表：2008年10月我国半导体器件等、已装配的压电晶体出口统计 337

图表：2008年1月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年2月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年3月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年4月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年5月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年6月我国集成电路及微电子组件进口统计 337

图表：2008年7月我国集成电路及微电子组件进口统计 338

图表：2008年8月我国集成电路及微电子组件进口统计 338

图表：2008年9月我国集成电路及微电子组件进口统计 338

图表：2008年10月我国集成电路及微电子组件进口统计 338

图表：2008年1月我国集成电路及微电子组件出口统计 338

图表：2008年2月我国集成电路及微电子组件出口统计 338

图表：2008年3月我国集成电路及微电子组件出口统计 338

图表：2008年4月我国集成电路及微电子组件出口统计 338

图表：2008年5月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2008年6月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2008年7月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2008年8月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2008年9月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2008年10月我国集成电路及微电子组件出口统计 339

图表：2003-2007年中国智能卡市场规模 352

图表：2004-2006年中国IC卡产业销售收入规模及增长 379

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxinshebei/3161731617.html>